



全球半导体行业周报

存储定价权、关税第二阶段与设备需求倍增：AI 供应链进入"合约锁定"与"政策定价"并行期

发布主体：百思特变革研究院半导体智库 | 期次日期：2026-09-07 | 覆盖窗口：2026-08-31 至 2026-09-06

本期总判断

本周三条主线同时收紧：存储定价权处于周期高点，美国关税第二阶段进入实施前夜，制造与设备需求由预期转为交付压力。资本市场分层定价，利率与油价构成外部约束。

一、存储定价权处于周期高点。SIA 7 月全球半导体销售额 1,468 亿美元、同比 +135.1%；韩国 8 月半导体出口 466.5 亿美元、同比 +209%、占出口 47.5%；36GB HBM3E 现货约 2,100 美元，为长约价 4-5 倍；三星约 70% 存储产能长约锁定至 2031 年。

二、政策定价进入实施前夜。美方 9 月 2 日确认半导体关税第二阶段沿用"在美建厂免税、不建厂缴税"模式；无人机 Section 232 关税 9 月 3 日生效，首次采用"能力分级 × 盟友分档"结构（100%/25%/15%/10%），为芯片关税提供税率模板；台湾以政府间配额机制先行并追加 200 亿美元对美投资；韩国依多边机制清单更新将 AI 芯片与先进设备纳入许可管理；Nexperia 在华五家实体股权被采取财产保全措施；印度发布 Semicon 2.0。

三、制造与设备需求由预期转为交付压力。台积电 2026 年设备采购需求量半年内由 1.0 倍升至 1.9 倍同期资本开支指引由 520-560 亿美元上调至 600-640 亿美元（中值 +15%），需求量增长快于采购金额；SEMI 二季度设备出货 405.3 亿美元连续两季创纪录；瓶颈转向建厂人力、ABF 载板、电力与 HBM 基础裸片；长鑫启动 HBM3E 风险量产，国产 HBM 认证候选时点为 2027 年。

四、资本市场分层定价。费城半导体指数周涨 2.32%；存储股领涨（SanDisk +17.2%、Micron +9.0%）；光通信与定制 ASIC 回落（Credo -26.7%、博通 -3.0%）；科创 50 周跌 5.10%。

五、宏观约束。美债 10 年期收益率 4.78%，9 月 FOMC 加息概率约六成，布伦特原油周涨 7.8%。

六、下一阶段需要跟踪的关键变量：存储长约价格条款、关税配额资格与国别税率、设备与建厂人力交付节点、数据中心电力接入、HBM 供给与国产 HBM 认证。

目录

本周概览.....3

一、 本周要点.....7

二、 重大事件及其影响.....8

三、 行业景气与资本市场.....10

四、 存储周期与装备制造链.....11

五、 政策、贸易与供应链安全.....12

六、 重点企业动态.....13

七、 中国半导体产业链.....14

八、 行业会议与人物观点.....15

九、 趋势判断.....16

十、 主要风险与下周关注事项.....17

十一、 管理观察与行动建议.....19

阅读导引：企业决策层建议优先阅读本周要点、重大事件及其影响、趋势判断与管理观察；制造、存储与设备企业建议重点阅读存储周期与装备制造链、重点企业动态；政策研究者与资本市场研究者建议重点阅读行业景气与资本市场、政策贸易与供应链安全、主要风险与下周关注事项。

本周概览

关键指标（截至 2026 年 9 月 4 日收盘 / 9 月 6 日）

全球半导体月销售额（7 月，SIA） 1,468 亿美元 同比 +135.1%，环比 +6.4% 连续 17 个月环比增长	全球设备出货（2Q26，SEMI） 405.3 亿美元 同比 +23%，环比 +11% 连续两季创纪录	韩国半导体出口（8 月） 466.5 亿美元 同比 +209% 占韩国出口 47.5%
费城半导体指数（SOX） 11,735.26 周 +2.32% 年内 +65.7%，较 6 月峰值低 19.8%	科创 50 指数 1,577.36 周 -5.10% 半导体 ETF 周 -6.06%	HBM3E 36GB 现货价 ≈2,100 美元 长约价的 4-5 倍 16 层 HBM4 现货约 3,500 美元
博通 AI 半导体收入（FY26Q3） 167 亿美元 同比 +221% Q4 指引 217 亿美元	台积电 2026 年设备需求量 1.9 倍 需求量半年内 +90% 资本开支指引 600-640 亿美元，中值 +15%	美债 10 年期收益率 4.78% 周 +6bp 9 月 FOMC 加息概率约 50%-60%

一周大事记（2026 年 8 月 31 日至 9 月 6 日）

8 月 31 日 周一	- 中国 8 月制造业 PMI 49.8，高技术制造业 52.9 - 英伟达宣布 35 亿美元认购联发科可转债 - 闻泰科技公告 Nexperia 及 ITEC 在华五家实体股权被采取财产保全措施（上限 21.4 亿元、至 2029 年 8 月） - 印度正式发布 Semicon 2.0 - 欧盟在台北举办第二届欧台半导体产业对话 - CSEAC 2026 在无锡开幕 - 首尔经济披露 HBM3E 现货为长约价 4-5 倍 - SK 集团崔泰源称考虑在日本建存储厂 - AMD、Cisco、Humain 沙特 AI 集群投产
----------------	--

9月1日
周二

- 韩国公布 8 月出口，半导体 466.5 亿美元、同比 +209%
- 韩国依多边机制清单更新将 AI 芯片与先进设备纳入战略物项许可管理
- 据 The Information 报道，长鑫科技启动 HBM3E 风险量产、平头哥与寒武纪评估中
- 三星在 SEMICON Taiwan 公布 HBM5、zHBM 路线图
- ASML 称 10 台 High-NA EUV 在 4 家客户运行
- Credo 发布财报
- Micron 台湾工会推进罢工投票
- 全球债市抛售，费城半导体指数 -2.14%
- Apple 新 CEO John Ternus 就任
- Navitas GaN 器件在 GlobalFoundries 量产

9月2日
周三

- SEMICON Taiwan 开幕，台积电披露季度设备需求升至 1.9 倍，Google Vahdat 亚洲首场主题演讲
- 台湾方面宣布台企追加 200 亿美元对美投资
- 美方确认半导体关税第二阶段采用"在美建厂免税"原则
- 黄仁勋在 G20 相关会议提出 AI 产业"五层蛋糕"
- 博通盘后发布 FY26Q3 财报
- 燧原科技科创板申购
- 华虹公告无锡三期增资至 41.7 亿美元
- 美国海关发布供应链可视性预先规则
- KOSPI -4.0%
- IBM 发布 Nighthawk r2

9月3日

周四

- SEMI 公布 2Q26 全球设备出货 405.3 亿美元
- 美国无人机 Section 232 关税生效，税率按敏感能力与来源地分为 100%/25%/15%/10% 四档
- 博通 -2.7%，Ciena 财报后 -10.4%，HPE 发布财报
- 英伟达确认 129.3 亿美元收购 Hugging Face
- 长电科技通过 65 亿元定增预案
- 精智达签 15.76 亿元测试设备订单
- 美企 20 亿美元对韩投资
- KOSPI 午后 30 分钟急跌约 3% 后反弹
- Mizuho 下调 Intel 目标价至 92 美元
- 富时罗素宣布纳入中微公司、华虹宏力、澜起科技
- 台湾方面说明政府间关税配额机制
- Crusoe 与 Jane Street 130 亿美元、Nscale 与 Figure 35 亿美元算力合同
- 加州通过数据中心电价法案
- 住友化学 InP 外延片量产

9月4日

周五

- SIA 公布 7 月全球销售额 1,468 亿美元
- 美国 8 月非农 +16.2 万，9 月加息概率升至约六成
- 费城半导体指数 +3.37%，SanDisk +11.9%、Micron +6.1%
- 据 Bloomberg 报道，DeepSeek 拟采购至少 16 万颗昇腾 950DT
- Micron HBM 产能年底扩至 10 万片/月报道
- 华为何庭波发表"逻辑折叠"论文
- 中国发布含 800V 高压直流内容的数字化绿色化协同方案
- IFA 开幕，AMD Ryzen AI Max PRO 400、英伟达 N1X 亮相
- JPR 公布 2Q26 PC GPU 出货 7,550 万颗，独立 GPU 同比 +14.1% 创四年新高
- 科创 50 -2.10%，存储芯片板块主力净流出 219.1 亿元
- Flex 44 亿美元收购 EPC Power
- SK 海力士称 Solidigm 分拆"尚无决定"
- ASML 日本宣布扩员 40%

9月5日

周六

- 日方称日美 5,500 亿美元投资协定取得进展，AI 与芯片占重要分量
- Anthropic 招股书推迟至 9 月下旬公开，正敲定 150 亿美元上市前信贷
- FluidStack 完成 15 亿美元融资

9月6日
周日

- 韩媒披露日本对台积电熊本补贴最高 1.2 万亿日元、对 Micron 广岛最高 5,000 亿日元
- 申万宏源等券商周报维持 9 月反弹判断，建议关注国产算力链与存储
- 经 TrendForce、Tom's Hardware、Reuters、Bloomberg、新浪财经复核，周末未出现新增可核实的重大产业事件
- 本期正式版截稿

本周图表

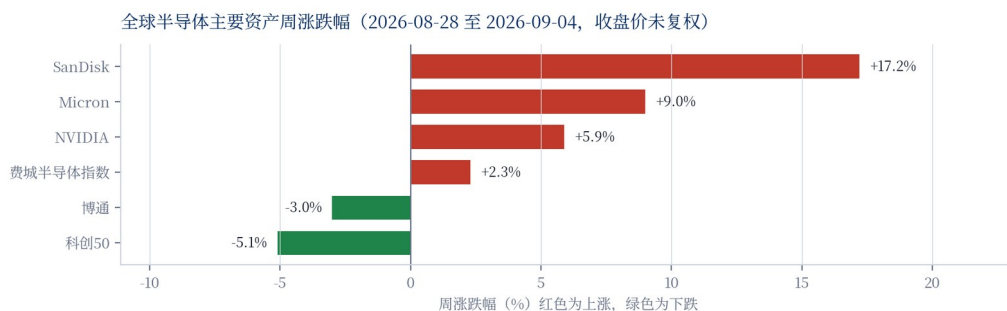


图1 全球半导体主要资产周涨跌幅（2026-08-28 至 09-04，收盘价未复权；数据来源：Yahoo Finance、腾讯行情）



图2 SEMI 2026 年二季度全球半导体设备出货分地区（数据来源：SEMI、SEAJ WWSEMS）

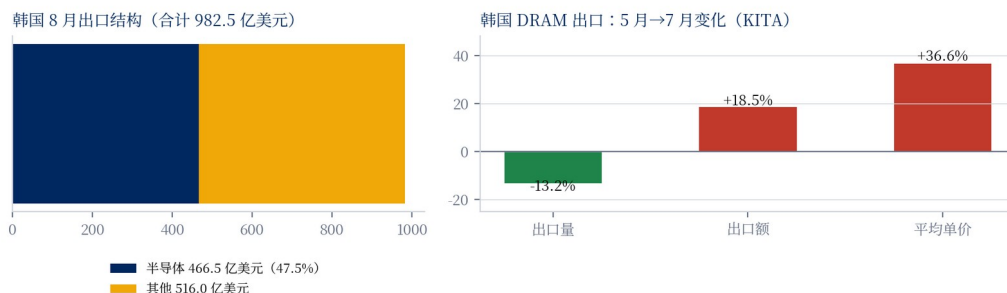


图3 韩国 8 月出口结构与 DRAM 出口量价变化（数据来源：韩国产业通商资源部、KITA）

一、本周要点

- **行业销售额创单月纪录，连续 17 个月环比增长。** SIA 9 月 4 日公布 2026 年 7 月全球半导体销售额 1,468 亿美元，环比增长 6.4%，同比增长 135.1%；前 7 个月累计销售额已超过历史上任何一个完整年度。美洲同比增长 171.3%，中国增长 123.6%，日本增长 50.8%。
- **设备出货连续两季创新高，区域结构显著分化。** SEMI 9 月 3 日公布二季度全球半导体设备出货 405.3 亿美元，同比增长 23%、环比增长 11%。中国大陆 119.1 亿美元（同比 +5%）仍居首位，但份额由一年前约 34% 降至 29.4%；韩国同比增长 54%，欧洲增长 70%，台湾增长 24%。日本 SEAJ 7 月日本制设备销售 5,562 亿日元，同比增长 35.4%。
- **韩国出口对半导体的依赖达到历史极值。** 8 月韩国半导体出口 466.5 亿美元，同比增长 209%，占总出口 47.5%。5 至 7 月 DRAM 出口量下降 13.2%、出口额增长 18.5%、平均单价上升 36.6% 至 22.90 美元，增长完全由价格驱动。
- **HBM 现货与长约双轨定价确立，存储厂商以长约锁定产能。** 36GB HBM3E 现货约 2,100 美元，为长约价 4–5 倍；16 层 HBM4 现货约 3,500 美元。三星存储部门约 70% 产能以长约锁定至 2031 年 Micron 拟年底前将 HBM 产能扩至约 10 万片/月；三星公布 HBM5（约 2028 年量产）与 zHBM（2029 年后）路线图。Susquehanna 预计本季 DRAM 合约价涨幅超过 50%、NAND 约 60%。
- **台积电设备采购需求量半年增长 90%，制造瓶颈转移至人力与载板。** 侯永清在 SEMICON Taiwan 披露，公司对 2026 年设备采购需求量的评估由 2025 年底规划的 1.0 倍升至一季度末的 1.5 倍、7 月的 1.9 倍；同期 2026 年资本开支指引由 520–560 亿美元升至 600–640 亿美元，中值增幅约 15%；公司同时在建约 20 座晶圆厂（含先进封装厂为 25 座），台湾洁净室建厂工人短缺、ABF 载板与日本中小供应商产能成为新的约束。
- **美国半导体关税第二阶段框架确认为"投资换豁免"。** 美方 9 月 2 日明确将沿用医药品 Section 232 模式；Politico 报道关税范围可能扩展至笔记本电脑、游戏主机与服务器等含芯片成品。台湾方面宣布台企近三个月追加 200 亿美元对美投资。美国无人机 Section 232 关税 9 月 3 日生效，税率分四档（100%/25%/15%/10%），为 Section 232 首次采用"敏感能力分级、盟友分档"结构。本周联邦公报无新的半导体出口限制规则或半导体关税第二阶段公告。

- **博通 AI 收入同比增长 221%，指引低于预期触发回调。** 博通 FY2026 Q3 营收 295.9 亿美元（+86%），AI 半导体收入 167 亿美元（+221%）；Q4 AI 收入指引 217 亿美元低于市场预期的 220-230 亿美元，股价 9 月 3 日下跌 2.7%。管理层将 FY2026 AI 收入指引上调至 580 亿美元，并给出 FY2027 约 1,150 亿、FY2028 约 2,300 亿美元的路径；ABF 载板成为其点名的关键供给约束。
- **英伟达以资本运作扩大生态控制范围。** 8 月 31 日宣布以 35 亿美元认购联发科可转债，双方围绕 NVLink Fusion 开发定制 XPU；9 月 3 日确认以 129.3 亿美元收购 Hugging Face，为其史上第二大交易。英伟达股价周涨 5.9% 至 230.36 美元。
- **中国国产 AI 芯片拿到规模化订单，二级市场转入业绩兑现阶段。** 据 Bloomberg 9 月 4 日报道，DeepSeek 计划为内蒙古约 1GW 算力项目采购至少 16 万颗华为昇腾 950DT；燧原科技科创板 IPO 9 月 2 日申购（发行价 142.18 元、募资 61.19 亿元、中签率 0.0246%）；长鑫科技上半年营收 1,503 亿元、二季度毛利率 87.59%，已启动 HBM3E 风险量产。同期科创 50 周跌 5.10%，北方华创、中微公司周跌逾 8.5%。
- **跨境法律与许可环境同步收紧。** Nexperia 在华五家实体的股权被采取财产保全措施（上限约 21.4 亿元、至 2029 年 8 月），不影响日常运营；韩国 9 月 1 日依多边机制清单更新将高性能 AI 芯片与部分设备纳入战略物项许可管理；美国海关发布供应链可见性预先规则，加强对转运的核查。

二、重大事件及其影响

事件	环节	对产业的影响	来源与可信度
SIA: 7 月全球半导体销售额 1,468 亿美元，环比 +6.4%，同比 +135.1%（9 月 4 日）	行业总量	按 7 月水平年化约 1.76 万亿美元，已超过 WSTS 6 月对全年 1.51 万亿美元的预测；增量主要来自存储涨价，剔除存储后全年增速约两成（Gartner 口径）	SIA 原文；高
SEMI: 2Q26 全球设备出货 405.3 亿美元，同比 +23%；中国大陆 119.1 亿（+5%）、台湾 108.9 亿（+24%）、韩国 90.8 亿（+54%）、欧洲 12.3 亿（+70%）（9 月 3 日）	设备	新增设备支出集中在韩国存储厂和台湾先进制程；中国大陆占比由约 34% 降到 29.4%，外资设备商在华增量收窄，国产设备商份额上升	SEMI 新闻稿、SEAJ 数据表；高

事件	环节	对产业的影响	来源与可信度
韩国 8 月出口 982.5 亿美元 (+68.7%)，半导体 466.5 亿美元 (+209%)，占比 47.5% (9 月 1 日)	存储/出口	出口增长基本靠涨价，DRAM 出口量在下降；存储价格回落或美国对韩系芯片加税，韩国出口与财政收入会同步受冲击	韩国产业通商资源部；高
台积电：2026 年设备采购需求量由 1.0 倍升至 1.9 倍，在建约 20–25 座厂；资本开支指引 600–640 亿美元 (9 月 2 日；7 月 16 日法说)	制造/设备	需求倍增在年内主要转化为订单前置、交付排期延至 2027 年与安装调试人力紧张，对设备商收入的传导落在 2027 年资本开支上调之后	Focus Taiwan、Bloomberg、台积电法说；高
美方确认半导体关税第二阶段采用"在美建厂免税、不建厂缴税"模式 (9 月 2 日)	政策	在美国有产能的企业按产能拿免税配额；若服务器、PC 一并纳入，AI 数据中心建设成本上升，CCIA 测算每年 GDP 损失约 900 亿美元	CNBC 访谈、Korea Times；高（税率与范围尚未公布）
博通 FY26Q3：AI 半导体 167 亿美元 (+221%)；Q4 AI 指引 217 亿美元；FY26/27/28 AI 收入 580/1,150/2,300 亿美元 (9 月 2 日)	定制 ASIC/网络	定制 ASIC 未来三年的需求由 Anthropic、OpenAI、Meta 的部署计划锁定；毛利率下降约 3 个百分点，存储与载板成本已传导到 ASIC 厂商	博通新闻稿与电话会；高
英伟达 129.3 亿美元收购 Hugging Face (9 月 3 日)；35 亿美元认购联发科可转债并合作 NVLink Fusion 定制 XPU (8 月 31 日)	GPU/生态	英伟达同时拿下开源模型的分发入口和 ASIC 设计方的互连接口；云厂商自研 ASIC 也要接入英伟达互连标准	NVIDIA 官网、SEC 8-K；高
HBM3E 36GB 现货约 2,100 美元 (长约价 4–5 倍)；三星约 70% 存储产能长约锁定至 2031 年；Micron HBM 产能拟年底达 10 万片/月 (9 月 1–4 日)	存储	大客户按长约拿货、成本可控；长约之外的买家（含中国大陆与二线云厂商）只能按 4–5 倍价格买现货；未来五年新增需求只能靠新建产能满足	首尔经济、ETNews、TrendForce；中高
DeepSeek 拟为内蒙古 1GW 项目采购至少 16 万颗昇腾 950DT (Bloomberg 9 月 4 日)；燧原科创板申购 (9 月 2 日)	中国产业链	国产 AI 芯片的约束由"能否适配"转为"能否交付"，HBM 与先进制程产能是决定变量	Bloomberg、上交所公告；中高/高
Nexperia 在华五家实体股权被采取财产保全措施（上限约 21.4 亿元）；韩国战略物项清单更新；美国海关供	政策/法律	跨境资产处置、设备许可与转运核查同步收紧，成熟制程供应链的法律风险上升	闻泰科技公告、韩国产业通商资源部、联邦公

事件	环节	对产业的影响	来源与可信度
应链可见性预先规则			报；高

三、行业景气与资本市场

本周集中发布的月度与季度数据形成一个完整的景气截面：总量增长处于历史最高水平，增长动力高度集中于存储价格，区域与品类间的分化在扩大，宏观利率与能源成本开始形成外部约束。7月1,468亿美元的月度销售额对应约1.76万亿美元的年化运行率，高于WSTS 6月预测的2026年全年1.51万亿美元与Gartner 8月24日给出的1.5552万亿美元；按Gartner口径，2026年存储收入8,373亿美元、占比54%，DRAM增长246.6%、NAND增长371.9%，非存储收入7,179亿美元、增长21.9%。二季度设备出货的区域结构显示本轮资本开支的真实流向：中国大陆119.1亿美元同比仅增长5%，份额由2Q25的约34%降至29.4%；韩国90.8亿美元同比增长54%，由HBM与DRAM扩产驱动；台湾108.9亿美元同比增长24%，对应先进制程与CoWoS扩产。

指标	最新值	变化	解读
全球半导体月度销售额 (SIA/WSTS, 7月)	1,468 亿美元	环比 +6.4%，同比 +135.1%	连续 17 个月环比增长；年化运行率约 1.76 万亿美元
分地区同比 (7 月)	美洲 +171.3%、亚太 +134.9%、中国 +123.6%、欧洲 +85.2%、日本 +50.8%	环比：日本 +9.2%、美洲 +8.7%、中国 +2.9%	中国环比增速最低，对华先进芯片供给受限与本土需求结构差异
全球设备出货 (SEMI, 2Q26)	405.3 亿美元	同比 +23%，环比 +11%	连续第二季创纪录；1Q26 为 365.5 亿美元
日本制半导体设备销售 (SEAJ, 7 月)	5,562 亿日元	同比 +35.4%，环比 +8.3%	3 个月移动平均口径；8 月数据 9 月 18 日发布
韩国半导体出口 (8 月)	466.5 亿美元	同比 +209%	占出口 47.5%；对美出口 165.0 亿美元 (+89.3%)
韩国 DRAM 出口单价 (KITA, 5→7 月)	22.90 美元	+36.6% (出口量 -13.2%)	价格驱动型增长，量的收缩对应产能向 HBM 倾斜

指标	最新值	变化	解读
台湾电子零组件出口（7月）	277.3 亿美元	同比 +50.5%（集成电路 +52.3%）	7 月外销订单同比 +61.9% 创纪录
中国集成电路出口（1-7月）	2,160 亿美元	同比 +99.5%	已超过 2025 年全年 2,019 亿美元
中国制造业 PMI（8 月）	49.8	+0.6 个百分点	高技术制造业 PMI 52.9；RatingDog 制造业 PMI 51.5
美国 8 月非农 / 失业率	+16.2 万 / 4.1%	预期约 5.3-5.5 万	9 月 15-16 日 FOMC 加息 25 个基点概率约 60%
美债 10 年期 / 布伦特 / 美元指数（9 月 4 日）	4.78% / 96.28 美元 / 99.16	周 +6bp / +7.8% / -0.5%	日本 10 年期国债收益率升破 3%，为 1996 年以来首次

资本市场方面，8 月 28 日至 9 月 4 日收盘，存储与 AI 硬件领涨，费城半导体指数收 11,735.26 点，周涨 2.32%，年内涨 65.7%，较 6 月 22 日峰值仍低 19.8%；SanDisk +17.2%、Micron +9.0%、SK 海力士 ADR +9.9%、Intel +7.1%、NVIDIA +5.9%；博通 -3.0%。亚太与中国市场分化：台湾加权指数 +0.47%，KOSPI 约 -1.5%（9 月 2 日单日 -4.0%），日经 225 -2.09%；科创 50 -5.10% 四连阴，半导体 ETF（512480）-6.06%，长鑫科技 -6.48%、北方华创 -8.5%、中微公司 -8.6%、澜起科技 -11.9%。本周形成的四层定价结构为存储 > GPU/平台 > 设备 > 光互连/ASIC，市场对"价格确定性"的偏好高于对"增速"的偏好；A 股半导体与全球存储行情的背离由估值消化、大额 IPO 与央企增资对流动性的分流所致，而非基本面分化。

四、存储周期与装备制造链

现货与长约之间 4-5 倍的价差是本轮周期最重要的定价特征。长约价格锁定了主要客户的成本，现货溢价对应长约之外的增量需求（包括中国大陆与二线云厂商）无处承接；TrendForce 指出 2Q26 起部分长约已加入价格上限条款，2027 年 70%-140% 的合约价涨幅预测更多对应新签长约与非长约部分。三星存储部门已将约 70% 产能以长约锁定至 2031 年，客户包括英伟达、微软与 Google；上半年三星半导体库存资产增长 32% 至 38.06 万亿韩元，其中在制品增长 35%，为 HBM 与先进 DRAM 的在制品堆积；SK 海力士上半年库存增长 26% 至 17.99 万亿韩元，结构相同。Micron 拟在年底前将 HBM 产能增加约 6 万

片/月至约 10 万片/月，重点扩大 12 层 HBM4 对英伟达 Vera Rubin 的供应。Bloomberg 引述报告称三星与 SK 海力士到 2028 年的新厂将使韩国存储产能增加约 60 万片/月，SK 海力士已批准 54.3 万亿韩元用于龙仁与清州新厂；TrendForce 预计 2027 年服务器 DRAM 与 HBM 位元供给增长 27%，CSP 资本开支 2026 年增长 98%、2027 年增长 50%，DRAM 与 NAND 占主要 CSP 资本开支的比重由 2026 年 47% 升至 2027 年更高水平。NAND 方面，3Q26 合约价 +10%–15%，2Q26 前五大企业级 SSD 营收 375.9 亿美元（环比 +103.6%），512Gb TLC 晶圆现货周跌 0.90%。

装备制造链的需求信号来自台积电。侯永清披露的“设备需求半年内由 1.0 倍升至 1.9 倍”针对设备采购需求量：台积电于 2025 年底对次年设备需求作出规划，至一季度末升至 1.5 倍，至 7 月升至 1.9 倍，公司称“无法跟上 AI 需求”；同期 2026 年资本开支指引路径为 1 月 520–560 亿美元、7 月 16 日 600–640 亿美元。台积电与欣兴在 SEMICON Taiwan 的表态共同指向一个结构性变化：设备本身的交付能力不再是唯一瓶颈，洁净室建厂工人短缺、ABF 载板产能与日本中小型工具材料供应商的产能成为新的约束。ASML 宣布日本员工由 500 人扩至 700 人，2026 年计划出货约 65 台 Low-NA EUV 与约 130 台 DUV 浸没机，2027 年产能增加 30%；High-NA 方面，10 台 EXE 系统在 4 家客户运行，另 3 台在出货安装，EXE 系列累计曝光超过 135 万片晶圆，EXE:5200B 验收吞吐 135 WPH，规划中的 EXE:5600 超过 250 WPH。技术路线上，Intel 14A 缺陷密度改善速度为 22nm 以来最快，0.9 PDK 10 月发布，2028 年量产，与台积电 A14 同期；台积电 N2 二季度占晶圆收入 3%、年底目标 10 万片/月，A16 按计划 2026 年下半年量产，目标 2029 年系统算力达 2024 年的 50 倍，硅光 2027 年将占光收发器市场 50% 以上；三星 HBM5（2nm 基础裸片，2028 年）、zHBM（2029 年后）；博通 Tomahawk 7（200T）流片，InP 产能扩 3 倍以上；力成拟投 700 亿新台币建全球首条面板级 AI 芯片封装线。

五、政策、贸易与供应链安全

美方 9 月 2 日通过 CNBC 专访首次确认半导体关税第二阶段的原则：在美国建厂的企业免税，不在美国建厂的企业缴税后进入市场，并明确将沿用医药品 Section 232 的结构。8 月 27 日 Politico 报道显示，第二阶段方案可能将关税由芯片本身扩展至笔记本电脑、游戏主机与数据中心服务器等含芯片成品，按各公司已承诺的美国产能设定免税进口配额。现行制度方面，2026 年 1 月 15 日生效的 Proclamation 11002 对符合特定算力与带宽门槛的先进芯片征收 25% 关税；8 月 6 日起对多晶硅征收 15% 关税；2 月

20 日美国最高法院裁定 IEEPA 不授权征收关税后，Section 232 成为美国最主要的宽口径关税工具。经对联邦公报 8 月 31 日至 9 月 6 日全库检索，本周没有新的半导体出口限制规则、清单变更或半导体 Section 232 第二阶段公告。三项待落实事项需要跟踪：美方正起草规则，限制中国 AI 企业通过泰国、新加坡等地数据中心远程租用 GPU；Section 48D 先进制造投资抵免要求晶圆厂在 2026 年 12 月 31 日前开工，逾期永久丧失资格，该抵免锚定了约 6,400 亿美元已宣布的美国本土芯片投资；加州立法机构 9 月 3 日通过 SB 886、AB 2383 等法案，对 75MW 以上大负荷用户设立单独电价。

其他经济体与法律层面：韩国 9 月 1 日依瓦森纳安排等四个多边机制的 80 余项清单变更，将高性能 AI 芯片、部分光刻、刻蚀与沉积设备纳入战略物项许可管理，对华实际影响取决于许可审批口径；台湾方面称台企近三个月追加 200 亿美元对美投资，以半导体、供应链与 AI 服务器厂商为主，并启动政府间配额磋商机制；闻泰科技公告，Nexperia 在华四家子公司及 ITEC（无锡）合计五家实体的股权被采取财产保全措施，上限约 21.4 亿元、至 2029 年 8 月，限制处置与重组但不影响日常运营；美国海关 9 月 2 日发布供应链可见性预先规则制定通告，评论期至 12 月 1 日；美中 AI 安全会谈拟于 9 月中旬举行，中美经贸磋商预计于 9 月下旬进行，芯片关税第二阶段与港口费安排续期为主要议题。

六、重点企业动态

企业	本周观察	后续验证点
NVIDIA	129.3 亿美元收购 Hugging Face（2027 年上半年完成）；35 亿美元认购联发科可转债并合作 NVLink Fusion 定制 XPU；已通知客户 2027 年初 AI 服务器涨价超 15%；采购承诺升至 2,790 亿美元；股价周涨 5.9% 至 230.36 美元	Hugging Face 交易反垄断审查、Rubin 出货、H200 对华销售执行
TSMC	设备采购需求量 1.0 倍升至 1.9 倍，资本开支指引 600–640 亿美元，在建约 20–25 座厂；2029 年系统算力 50 倍目标；硅光 2027 年占比超 50%；2027 年先进制程报价 +5%–10%；台股周跌 0.41%	8 月营收（9 月 10 日前后）、N2 爬坡、CoWoS 扩产
Samsung Electronics	HBM5/zHBM/zNAND-O 路线图；约 70% 存储产能长约锁定至 2031 年；上半年库存 +32% 至 38.06 万亿韩元；HBM 份额回升至 33%；Taylor 厂年底试产；三季度营业利润一致预期 116.38 万亿韩元	三季度初步业绩（10 月初）、HBM4 对英伟达出货

企业	本周观察	后续验证点
SK hynix	Solidigm 分拆上市"尚无决定"（9月4日 6-K）；印第安纳 HBM 封装厂 8 月 27 日动工；中国企业级 SSD 限制 2026 年底到期；ADR 周涨 9.9%	Solidigm 决定、三季度业绩、40 万亿韩元回购执行
Micron	HBM 产能拟年底达约 10 万片/月；台湾工会推进罢工投票（调解 9 月中旬）；FQ4 指引营收 500 亿美元、毛利率约 86%；股价周涨 8.98%	9 月 30 日财报、罢工调解结果、HBM4 12 层对 Rubin 供应
Intel	14A 缺陷密度改善为 22nm 以来最快、0.9 PDK 10 月发布、2028 年量产；Nova Lake 四季度量产；股价周涨 7.07%、年内 +160%	14A 客户公告、Panther Lake 良率、Q3 代工外部收入
Broadcom	FY26Q3 AI 半导体收入 167 亿美元（+221%），Q4 指引 217 亿美元，FY26/27/28 目标 580/1,150/2,300 亿美元；Tomahawk 7 流片；自建载板产能；毛利率下降约 3 个百分点	Q4 兑现、载板供给、Anthropic 5GW TPU 部署
ASML	2026 年计划出货约 65 台 Low-NA EUV 与约 130 台浸没 DUV，2027 年产能 +30%；10 台 High-NA 在 4 家客户运行；日本员工扩至 700 人	三季度订单、High-NA 量产客户增加

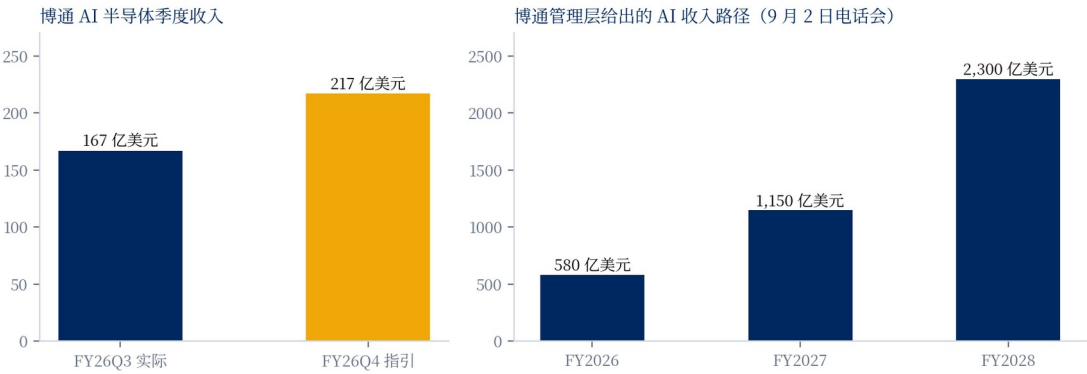


图 4 博通 AI 半导体季度收入与管理层给出的多年收入路径（数据来源：博通 FY26Q3 新闻稿与电话会）

七、中国半导体产业链

设计端拿到规模化订单。DeepSeek 计划在内蒙古乌兰察布约 1GW 算力项目中部署至少 16 万颗华为昇腾 950DT 用于推理，设施预计 2027 年末至 2028 年初部分上线，按约 11.1 万元/颗估算订单规模约 25.6 亿美元；报道同时指出高端存储等组件供应将制约 950DT 产量，完成订单可能超过一年。此前

DeepSeek-V4 已完成对昇腾 950PR、天数智芯、寒武纪的全栈适配，阿里、字节、腾讯提前下单数十万颗 950PR，国产 AI 芯片的约束已由“能否适配”转为“能否交付”。燧原科技科创板 IPO 9 月 2 日申购：发行价 142.18 元，募资 61.19 亿元，发行市值约 611.87 亿元，网下 337 家机构申购倍数 2,648.93 倍，网上中签率 0.02455%，腾讯、兆易创新、小米、通富微电、中兴通讯、华虹集团及社保基金参与战略配售。

制造与存储端，长鑫科技上半年营收 1,503 亿元、净利 776.05 亿元、二季度毛利率 87.59%，市值约 3.72 万亿元居 A 股首位，本周股价下跌 6.48%；据 The Information 9 月 1 日报道，长鑫已启动 HBM3E 风险量产，平头哥、寒武纪等正以自身处理器评估，认证顺利则最早 2027 年用于商业产品，长鑫 HBM3E 的认证进度由此成为 DeepSeek 订单交付周期的决定变量。华虹无锡三期增资至注册资本 41.7 亿美元、新增 5.5 万片/月产能，华虹产能利用率 102.8%，中芯 93.7%；长电科技拟定增不超过 65 亿元。设备端，中国大陆二季度设备采购同比仅增长 5%、份额降至 29.4%，而中微、盛美、精智达等国产设备商订单高增，进口设备份额正在被替代；UBS 9 月 2 日报告认为中国浸没式 DUV 或在 2-5 年内量产，EUV 十年内难以实现。资本市场端，科创 50 周跌 5.10%、四连阴，半导体 ETF -6.06%，北方华创中微公司周跌逾 8.5%，澜起科技 -11.9%，与全球存储股反向；大额 IPO、央企增资与估值消化是主要原因。据《金融时报》报道，境外流片限制措施若实施，依赖台积电的自研芯片项目需评估向中芯国际 N+2/N+3 迁移的时间与性能代价。

八、行业会议与人物观点

SEMICON Taiwan 2026（9 月 2-4 日，台北）规模创纪录：1,300 余家展商、4,300 个展位、60 余个国家和地区、18 个国家馆，预计观众超过 10 万人，新增量子科技区与智能晶圆厂区；首次全天举办的 CEO 峰会由 Google 的 Amin Vahdat 做亚洲首场公开主题演讲，微软 Azure 硬件总裁 Rani Borkar、Micron 总裁兼 CTO Scott DeBoer、英伟达 CTO Michael Kagan 参与，台积电侯永清、ASML High-NA 产品负责人、三星、欣兴在此披露技术路线与产能约束。Hot Chips 2026（8 月 23-25 日，斯坦福）披露英伟达 Vera CPU（88 核 Olympus、1.2TB/s LPDDR5X）、Vera Rubin NVL72、BlueField-4 与 Groq 3 LPU；Meta MTIA 400 FP4 算力 12 PFLOPS；Google 第八代 TPU 分训练与推理两颗芯片；OpenAI 首次公开芯片设计。IFA 2026（9 月 4-8 日，柏林）安克、绿联等举办发布会。未来两周：花旗

全球 TMT 大会（9 月 8-9 日）、高盛 Communacopia（9 月 9 日起）、Apple 发布会（9 月 9 日）、Arm 股东大会（9 月 9 日）、华为全联接大会（9 月 17-19 日）、Micron 财报（9 月 30 日）。

本周可核实的企业界表态集中于算力供给与投资两个议题。侯永清（台积电，9 月 2 日）："无法跟上 AI 需求"，设备需求量半年内由 1.0 倍升至 1.9 倍，洁净室建厂人力与载板供应成为新的约束。黄仁勋（英伟达，9 月 2 日）在 G20 相关会议上以"五层蛋糕"描述 AI 产业结构，能源与芯片处于底层，应用与服务位于顶层。崔泰源（SK 集团，8 月 31 日）称考虑在日本建设存储厂。欣兴电子（9 月 2 日）确认 ABF 载板产能紧张将持续至 2027 年。政策层面的表态以公开公告为准：美方确认半导体关税第二阶段采用"在美建厂免税、不建厂缴税"原则，第二阶段税率与范围尚未公布；台湾方面披露台企近三个月追加 200 亿美元对美投资，2025 年台湾半导体产值 2,091 亿美元、增长 22.7%。

九、趋势判断

- **存储定价权将在 2026 年四季度至 2027 年一季度触顶，此后涨幅逐季收敛而非逆转。** 现货与长约 4-5 倍价差已是极值，长约自 2Q26 起加入价格上限条款；2027 年服务器 DRAM 与 HBM 位元供给仅增 27%，低于 CSP 资本开支 50% 的增速，价格不具备 2027 年回落的供给基础；2028 年韩国新增约 60 万片/月产能、长鑫与长江存储扩产以及终端需求收缩（手机 -16.7%、笔记本 -9.4%）将在 2027 年下半年进入价格预期。
- **成本传导进入系统层，AI 芯片与服务器厂商的毛利率进入下行通道。** 博通毛利率下降约 3 个百分点并自建载板产能，英伟达通知客户 2027 年初 AI 服务器涨价超 15%，Dell AI 积压 950 亿美元但存储与载板成本同步上升；存储与载板的涨价正在由芯片厂商向系统厂商与云厂商传导。
- **设备订单的可见期延长至 2027 年下半年，但资本市场对设备股的定价已经进入"以 2027 年 WFE 方向为锚"的阶段。** 台积电设备需求量 1.9 倍与交付排期延至 2027 年确认订单可见期；日本设备股周跌 5%-8%、北方华创与中微周跌逾 8.5%，说明市场在交易 2027 年 WFE 增速回落的预期；AMAT 在高盛 Communacopia 对 2027 年 WFE 的表态为近期验证点。
- **美国关税第二阶段将在 9 月下旬中美经贸磋商前后公布，"投资换豁免"将把各国对美投资承诺转化为可交易的配额资产。** 药品模式（在美生产换豁免）、按已承诺产能设定配额、按国别差异化税率三

种实施模式对台湾、韩国、日本与中国大陆的影响差异显著；无人机 232 关税的"能力分级 × 盟友分档"结构是芯片关税的可能模板。

- **中国国产 AI 芯片由验证转入交付，约束由软件生态转向 HBM 与先进制程产能。** DeepSeek 16 万颗订单与字节、阿里、腾讯的预订使需求确定，交付周期取决于长鑫 HBM3E 认证（最早 2027 年）N+3 产能与先进封装良率；2026 年国产 AI 芯片需求约 400 万颗、交付约 300 万颗的缺口在年内不会消失。
- **AI 基础设施的融资层继续扩张，但利率上行正在改变其成本结构。** 本周新增算力合同超 500 亿美元，10 年期美债 4.78%、9 月加息概率约六成，项目融资成本上升；Anthropic IPO 推迟、SB Energy 递表、Oracle 财报是四季度融资层的三个观察点。
- **电力已成为与芯片同等级的硬约束，功率半导体与供电架构的价值量系统性上升。** 加州大负荷用户单独电价法案、KEPCO 预付 25 万亿韩元要求、800V 高压直流中美同步推动、Flex 44 亿美元收购 800V 电源商，指向数据中心供电从配套环节变为投资决策变量。
- **GPU 与定制 ASIC 的竞争正在演变为生态与资本的竞争。** 英伟达一周内以 129.3 亿美元收购 Hugging Face、35 亿美元投资联发科，把开源模型分发入口与 ASIC 互连接口纳入自身体系；博通以 Anthropic 5GW TPU 与 OpenAI 1.3GW 自研芯片锁定三年需求，双方的竞争焦点已从单芯片性能转向互连标准、软件生态与客户资本结构。

十、主要风险与下周关注事项

领域	当前判断	主要风险	观察指标
HBM / 服务器 DRAM	现货为长约 4-5 倍；2026 年服务器 DRAM 合约价约 +270%；2027 年 HBM +70%-140%；供给位元 2027 年仅 +27%	长约价格上限条款；2028 年韩国新增 60 万片/月；终端需求破坏（手机 -16.7%、笔记本 -9.4%）	4Q26 合约价、Micron 9 月 30 日财报、三星/SK 海力士三季度业绩
NAND / 企业级 SSD	3Q26 合约价 +10%-15%；2Q26 前五大企业级 SSD 营收 375.9 亿美元（环比 +103.6%）	512Gb TLC 晶圆现货周跌 0.90%；长江存储三期与 Kioxia 北上 Fab3 新增供给	NAND 合约价、Kioxia/SanDisk 指引
先进制程与	台积电设备需求量 1.9 倍、资本开支	建厂人力短缺；载板短缺；	台积电 8 月营收、三季度法

领域	当前判断	主要风险	观察指标
CoWoS	600-640 亿美元；N2 年底 10 万片/月；2027 年先进制程报价 +5%-10%	关税配额限制美国出货	说、CoWoS 月产能
设备 / 材料	SEMI 2Q26 出货 405.3 亿美元；SEAJ 7 月 +35.4%；中国大陆同比仅 +5%	2027 年 WFE 增速回落预期压制估值；日本设备股周跌 5%-8%	SEAJ 8 月数据、SEMI 北美账单、ASML 三季度订单
AI 服务器与算力项目	Dell 积压 950 亿美元；本周新增算力合同超 500 亿美元；CSP 资本开支 2026 年 +90%-98%	利率上行提高项目融资成本；电力与社区反对；Anthropic IPO 推迟	融资关闭、并网时间、Oracle 财报、Anthropic S-1
电力 / 散热	加州大负荷用户单独电价法案；KEPCO 预付 25 万亿韩元要求；800V 高压直流中美同步推动	并网延期、电价上涨、PUE 不达标	加州法案签署结果、MGX 800V 机架交付
终端	iPhone 18 系列涨价 10%-20%；PC 价格 +17%、手机 +13%（Gartner）；JPR 2Q26 独立 GPU 出货同比 +14.1%	存储成本挤压终端毛利与出货量	Apple 发布会定价、三季度 PC/手机出货
中国产业链	DeepSeek 16 万颗昇腾订单；燧原 IPO；长鑫 HBM3E 风险量产；科创 50 周跌 5.10%	HBM 与 N+3 产能约束；估值消化；合规与诉讼风险	燧原首日定价、8 月集成电路进出口、长鑫 HBM3E 认证
政策	关税第二阶段"投资换豁免"；无人机 Section 232 关税生效；韩国多边清单落实；Nexperia 财产保全措施	含芯片成品纳入关税；9 月下旬中美经贸磋商结果；48D 抵免 12 月 31 日截止	Section 232 公告、磋商结果、国会延期立法

日期	事件	关注要点	需要修正本期判断的情形
9 月 7 日	中国 8 月进出口数据	集成电路出口金额与同比（1-7 月累计 +99.5%）	单月同比低于 60%，高基数效应开始出现，出口拉动减弱
9 月 7 日	华为 Mate XT 2 发布	麒麟 9050 Pro 的工艺代次、能效实测	若采用 N+3 且能效达到论文宣称值，需上调对国产先进制程的判断
9 月 7-9 日	台湾 8 月出口数据	集成电路出口同比（7 月 +52.3%）	集成电路同比低于 25%，视为 AI 相关出货放缓的信号
9 月 8 日	江波龙 H 股挂牌；联发科可	江波龙首日相对 A 股约 40% 的折	首日破发，港股半导体 IPO 窗口收

日期	事件	关注要点	需要修正本期判断的情形
	转债新交所挂牌	价能否收窄	紧，后续 A+H 定价需下调
9 月 8-9 日	花旗全球 TMT 大会	意法半导体 CFO 对功率器件涨价的表态；Astera Labs 对 Rubin 互连需求的表态	意法半导体若称车规需求转弱，需下调功率器件景气判断
9 月 9 日	Apple 发布会	iPhone 18 Pro 与折叠款的存储配置、起售价，A20 Pro（2nm）规格	涨价幅度超过 15%，终端需求受损将比本期预计更早出现
9 月 9 日起	高盛 Communacopia 大会	Applied Materials、博通、Amkor 对 2027 年 WFE 与 AI 收入的表态	AMAT 若下调 2027 年 WFE 展望，设备股回调将延续
9 月 10 日前后	台积电 8 月营收	7 月为 4,675.8 亿新台币（+44.7%）	同比低于 35% 需重估先进制程需求节奏；高于 45% 则确认设备需求量 1.9 倍与资本开支上端执行
9 月中旬	Micron 台湾工会调解	是否进入罢工	罢工持续两周以上，HBM 供给缺口扩大，存储价格判断上调
9 月下旬	中美经贸磋商	芯片关税第二阶段、先进芯片出口限制、港口费安排续期	若公布关税第二阶段且含服务器与 PC，AI 数据中心建设成本判断需上调

十一、管理观察与行动建议

对芯片设计与系统企业，将存储长约条款作为 2027 年毛利率管理的核心变量，参照三星 70% 产能锁定至 2031 年与长约价格上限的实践，在 HBM、服务器 DRAM 与企业级 SSD 长约中同时设定价格上限、数量弹性与技术代际切换条款，对长约之外的增量需求按现货价 4-5 倍的溢价建立成本预案；在架构层对冲存储成本，Google TurboQuant 将 KV cache 压缩至 3 位、台积电 SoIC 与 COUPE 降低数据搬运、Meta MTIA 400 采用 FP4 精度，均是以设计换存储的案例；提前测算关税第二阶段的配额资格，梳理自身及代工伙伴在美产能、封装地点与成品进口路径；将载板、光器件与电源纳入关键物料清单，建立二级供应商地图。

对制造、存储与封测企业，以长约覆盖率与价格上限结构管理周期风险，2027 年供给增量 27% 与 2028 年韩国新增 60 万片/月是价格拐点的候选触发因素；将劳资、电力与建厂人力纳入扩产可行性评估，Micron 台湾罢工投票、KEPCO 预付电费、台湾洁净室工人短缺表明扩产的约束已由资本与设备转向人力与能源。

对设备与材料企业，订单可见期已延长至 2027 年下半年，交付能力是竞争焦点，台积电设备需求量 1.9 倍而 2026 年资本开支指引中值仅 +15%，需求倍增在年内体现为订单前置与交付排期延长；重新评估中国大陆市场的份额与结构，中国大陆二季度设备采购同比仅增长 5%、份额降至 29.4%，而中微、盛美、精智达等国产设备商订单高增。

对中国产业链企业，交付能力优先于新品发布，DeepSeek 16 万颗订单与字节、阿里、腾讯的预订使需求确定，交付周期取决于 HBM 供给、N+3 产能与先进封装良率；为境外流片限制的可能实施做预案，评估向中芯国际 N+2/N+3 迁移的时间与性能代价，提前锁定国产 EDA、IP 与封装资源。

对政策研究者，关税第二阶段的三种实施模式（药品模式、按已承诺产能设定配额、按国别差异化税率）应分别建模，对台湾、韩国、日本与中国大陆的影响差异显著；区分多边机制清单落实与单边规则韩国 9 月 1 日战略物项公告修订属多边机制清单变更的落实，与美国单边规则的衔接体现在许可审批而非清单文本。

对上市公司与资本市场研究者，采用分层定价框架跟踪半导体资产，本周形成的四层结构（存储 > GPU/平台 > 设备 > 光互连/ASIC）对应市场对价格确定性的偏好；A 股半导体与全球存储行情的背离是估值消化而非基本面分化，长鑫、澜起、兆易与全球存储股的反向走势、科创 50 四连阴、大额 IPO 与央企增资对流动性的分流均指向估值层面。

数据来源与口径

涨跌幅以 2026 年 8 月 28 日与 9 月 4 日收盘价计算，价格未复权，不同市场不做汇率换算；美股与亚太数据来自 Yahoo Finance 行情接口，A 股与港股数据来自腾讯行情接口。金额单位美元用"亿美元/万亿美元"，人民币"亿元"，韩元"万亿韩元"，日元"亿日元"，新台币"亿新台币"。关键数字来自 SIA、SEMI、SEAJ、韩国产业通商资源部、KITA、TrendForce、台积电、博通、英伟达、SEC EDGAR、联邦公报、巨潮资讯、上交所、港交所公告，事件报道来自 Bloomberg、Reuters、CNBC、The Information、

Politico、Focus Taiwan、首尔经济、ETNews、财联社。美方所称"1.2 万亿美元对美芯片投资承诺"、美方对韩系存储芯片征收最高 100% 关税的讨论、DeepSeek 订单具体金额（按单价估算）、上海微电子 EUV 传闻、三星代工 9 月涨价幅度等信息未取得一手来源，未作为确定事实写入判断。

本报告由百思特变革研究院半导体智库基于公开信息编制，数据截至 2026 年 9 月 6 日 21:40（北京时间）。报告内容仅供行业研究参考，不构成任何投资建议，不代表任何政府机构或监管部门的立场；所涉政策信息均来自公开发布的法规、公告与新闻报道；引用请注明出处。